

株式会社 アルバック

# 2026年6月期 第1四半期 決算説明資料

2025年7月～2025年9月

2025年11月11日

## 将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**  
本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
- **数字の処理について**  
本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。
- **品目名称変更について**  
2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

ULVAC

**■ 2026年6月期 第1四半期 連結業績概要**

- 受注高・売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地
- 前年同期比・前4Q比で売上高減少およびミックス変化により一時的に利益率低下

**■ 新中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗**

- 事業改革・生産改革などの取り組みは計画通りに進行中  
早期実現に向けて各施策を推進中
- ポンプ用モーター事業：譲渡完了  
マテリアル関連生産（日本富里工場）：生産終了

**■ 2026年6月期 業績予想**

- 下期にかけて着実な改善を見込み、業績予想・配当予想に修正なし

サマリーからご説明します。

一点目、当1Qは、受注高、売上高、各利益項目ともに概ね計画通りに着地しました。利益率については、前年同期比および前4Q比で売上高の減少およびミックスの変化により、一時的に低下しています。

二点目、新中長期経営計画、バリューアッププランの進捗については、事業改革などの取り組みは計画通りに進行中しており、早期実現に向けて各施策を推進しております。なお、ポンプ用モーター事業の一部持分の譲渡は完了しております。また、マテリアル関連の富里工場での生産は終了しています。

三点目、当期の通期業績予想につきましては、下期にかけて着実な改善を見込んでいるため、業績予想および配当予想に修正はございません。

## 2026年6月期 第1四半期 連結業績概要

- ▶ 1Q受注高・売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地
- ▶ 前年同期比・前4Q比で売上高減少およびミックス変化により一時的に利益率低下

【単位：億円】	2025/6期					2026/6期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	前年同期比 増減額 増減率	
受注高	509	655	475	617	2,256	604	+95	+19%
売上高	610	739	529	635	2,512	527	-83	-14%
売上総利益	191	238	176	193	799	157	-35	-18%
率	31.3%	32.2%	33.3%	30.5%	31.8%	29.7%	-1.6pt	
販管費	134	142	122	136	533	134	+0	+0%
営業利益	58	96	54	58	265	23	-35	-60%
率	9.4%	13.0%	10.2%	9.1%	10.6%	4.3%	-5.1pt	
経常利益	69	92	61	65	286	25	-44	-64%
率	11.3%	12.4%	11.5%	10.2%	11.4%	4.7%	-6.6pt	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	37	67	27	36	167	17	-21	-55%
率	6.1%	9.0%	5.1%	5.6%	6.6%	3.2%	-3.0pt	

Copyright © 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

3

1Qの業績概要です。

受注高は604億円となり、概ね計画通りに着地しました。

売上高は527億円で、前年同期比および前4Q比で減少していますが、  
期初からスロースタートになると想定しており、こちらも概ね計画通りの結果となりました。

利益率については、売上高の減少およびミックス変化の影響により一時的に低下しています。

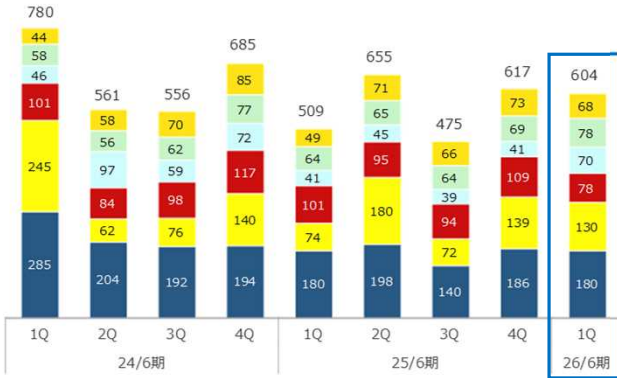
## 受注高・売上高実績

- » 受注高：OLED改造案件・追加投資継続等により、前年同期比増加
- » 売上高：概ね計画通りも、半導体電子の売上高構成比が一時的に低下

### 受注高

【単位：億円】

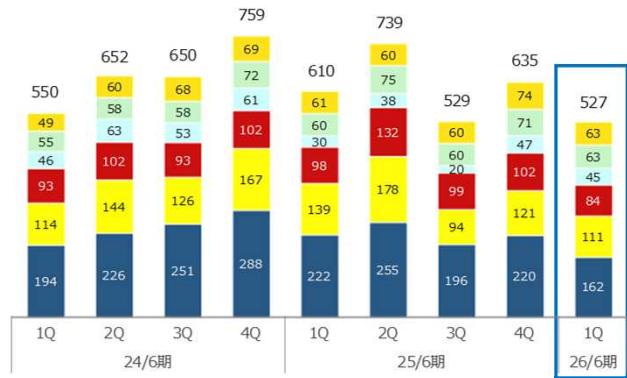
■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ マテリアル  
 ■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



### 売上高

【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ マテリアル  
 ■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

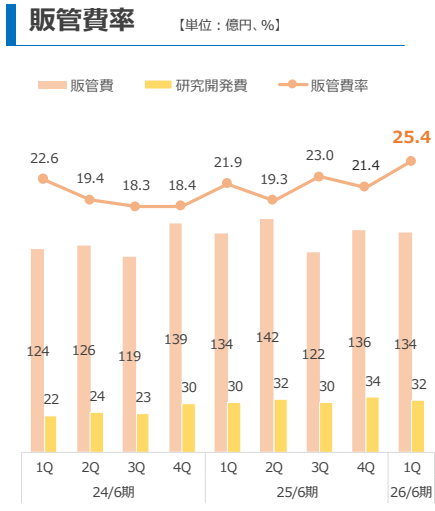
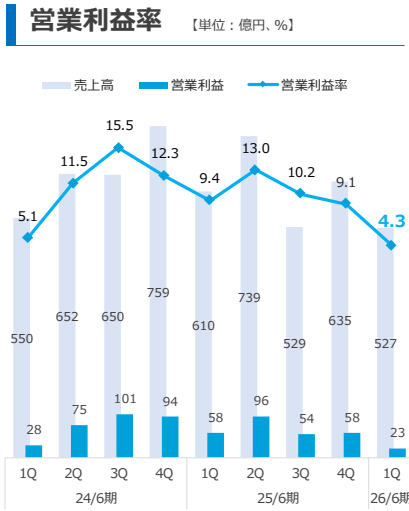
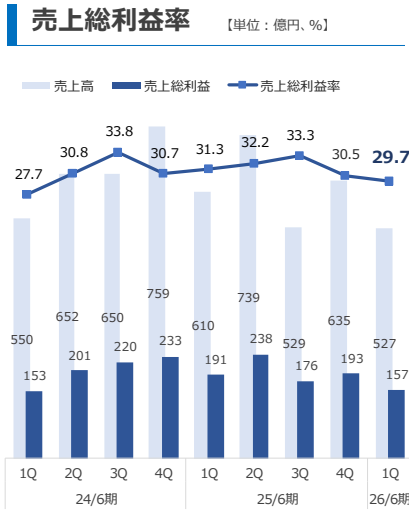
品目別ごとの受注高・売上高実績です。

左側の受注高は、主に黄色で示されたディスプレイ・エネルギー関連において、OLED改造案件や追加投資の継続などが寄与し、前年同期比で増加しました。その結果、受注高は604億円となりました。

一方、右側の売上高は、受注残高の減少に伴い、主に半導体電子の売上高が減少しました。これにより、全体の売上高は527億円となり、半導体電子の売上高構成比も一時的に低下しています。

# 利益率推移

- » 売上総利益率：売上高減少およびミックス変化により一時的に低下
- » 営業利益率：売上総利益減少に加え、研究開発投資継続等により低下



利益率の推移です。

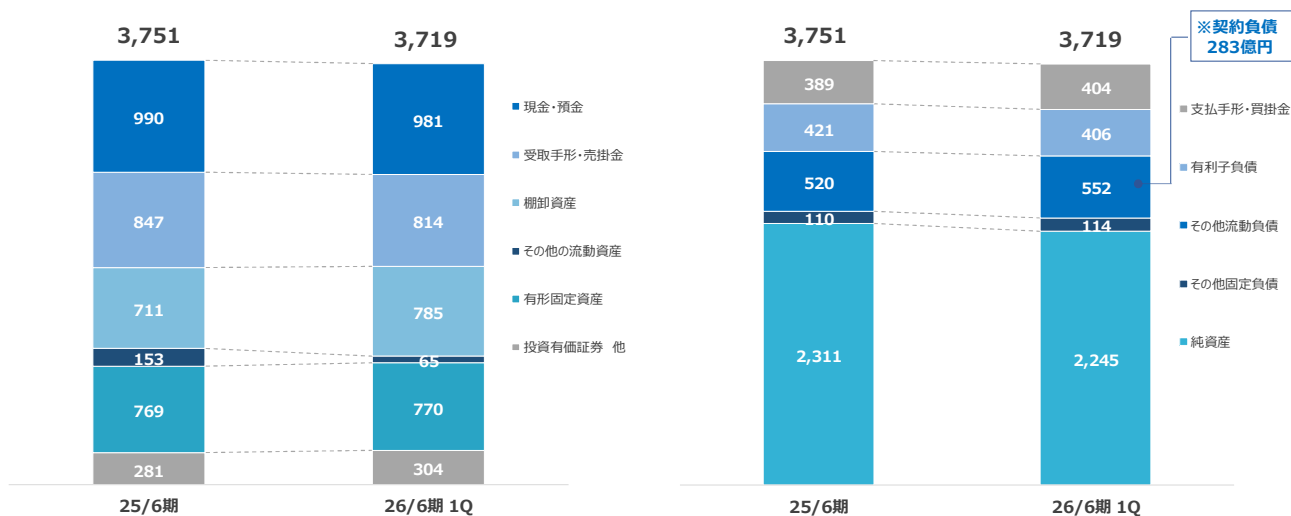
左の売上総利益率は、売上高の減少および一時的なミックス変化の影響により低下し、29.7%となりました。

中央の営業利益率は、売上総利益の減少に加え、右グラフに記載の研究開発投資の継続により低下し、4.3%となっています。

# 貸借対照表

## 資産【単位：億円】

## 負債・純資産【単位：億円】



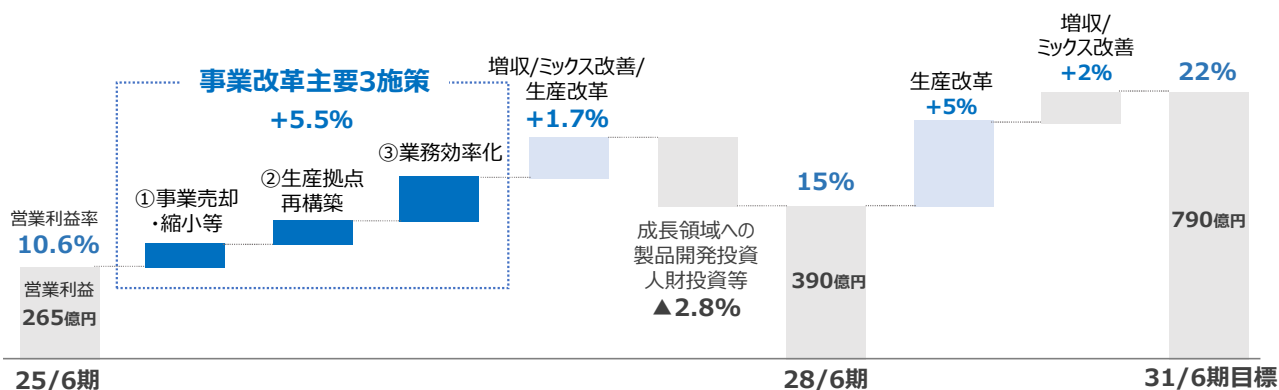
Copyright © 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

バランスシートの状況です。

配当金の支払いなどにより純資産が減少した結果、総資産は前期末より32億円減少し、3,719億円となりました。

# バリューアッププランの進捗

» 事業改革・生産改革などの取り組みは計画通りに進行中、早期実現に向けて各施策を推進中



事業改革	主要3施策	内容
	① 事業売却・縮小等	持分譲渡による非連結化を含み6事業の売却・縮小等に向けて交渉中 → <b>1事業譲渡完了</b>
② 生産拠点再構築	工場縮小（1拠点） → <b>生産終了</b> 工場内一部事業の生産縮小後、他事業転用（2拠点）に向けて対応中	
③ 業務効率化	業務・機能の統合等による業務効率化に向けて対応中	
生産改革	MD化による調達・部品共通化による変動費削減、設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減：進行中	

## バリューアッププランの進捗については

事業改革・生産改革などの取り組みは計画通りに進行しており、早期実現に向け各種施策を推進しています。

## 事業改革の中の主要3施策については

まず、事業売却・縮小等では、持分譲渡による非連結化を含み6事業の売却・縮小等に向けて交渉を進めており、そのうち1事業は譲渡が完了しています。

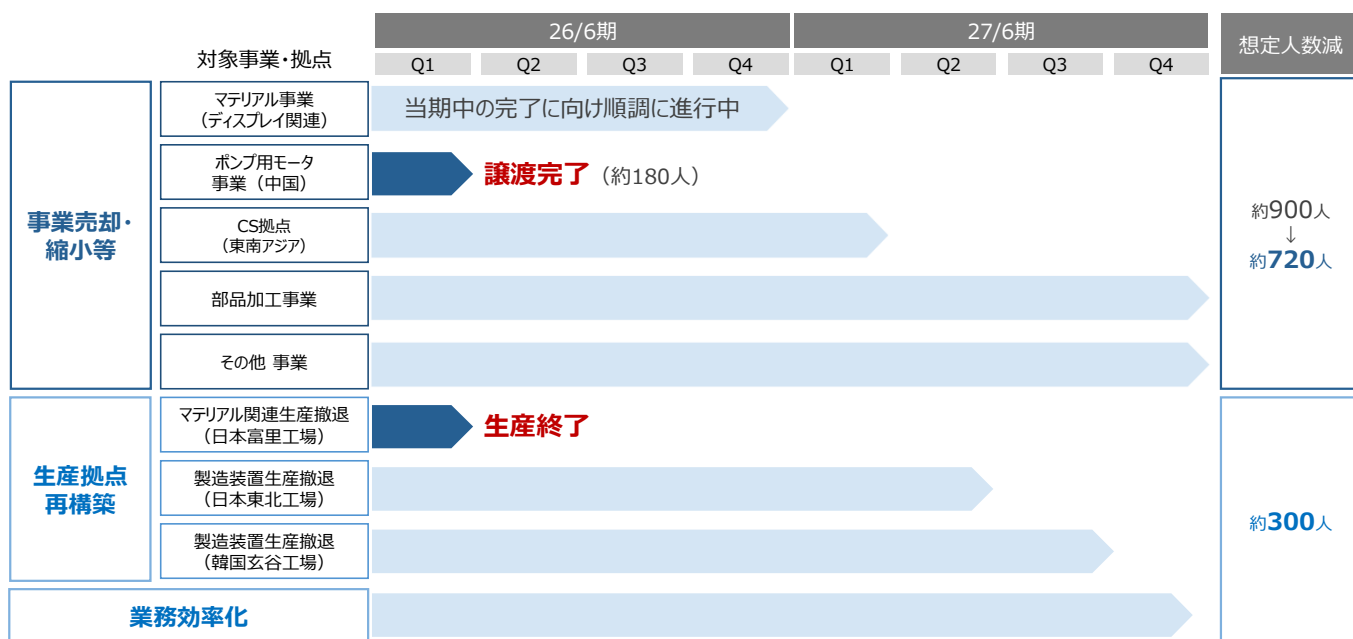
次に、生産拠点再構築では、1拠点の工場縮小に関しては生産が終了しており、その他の2拠点については、生産縮小・他事業への転用に向けて対応中です。

さらに、業務効率化については、業務・機能の統合などを進めています。これらの改革を断行することで、利益率ベースで5.5ptの改善を見込んでおります。

生産改革では、モジュラーデザイン化による調達・部品共通化を推進することで変動費削減を図るとともに設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減の取り組みを進めております。

# 事業改革の進捗状況

» 事業売却・縮小：1件譲渡完了、生産拠点再構築：1件生産終了



Copyright © 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

事業改革の主な施策のロードマップです。

足元では、一番上マテリアル事業（ディスプレイ関連）においては、当期中の完了に向け順調に進行しております。

上から2つ目のポンプ用モーター事業の一部持分の譲渡が完了し、連結子会社から持分法適用会社へと移行しています。また、真ん中ではマテリアル関連の富里工場での生産は終了しております。

その他、各施策の取り組みは計画通りに進行しており、事業改革の取り組みは2年間で完遂を目指しています。

今後もこのように、事業改革の各案件ごとに進捗状況を適宜公表してまいります。

## 投資動向

品目	投資動向	CY25~26
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRAM：HBM関連投資活況、新規顧客投資の1Qからの貢献</li> <li>NAND：次世代向け投資継続</li> <li>ロジック：先端ノード投資堅調、成熟ノードMHM工程展開の加速、北米における外資メーカーによる投資開始見込み</li> </ul>	
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>生成AI向けWLPビジネス継続、Hybrid bonding向け投資期待</li> <li>PLP開発投資見込み</li> <li>AR/VR向け中国オプトデバイス投資見込み</li> </ul>	
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>中国大手デバイスメーカー中心に8inchSiC投資の引き合い増加も一部顧客からの遅延要請等もあり受注タイミング遅延傾向</li> </ul>	
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>IT OLED向け投資継続、設備追加・改造案件による持続的貢献</li> </ul>	
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>複合集電体への期待が高まるも、依然として市場形成は不透明</li> <li>銅両面蒸着膜・リチウム膜等を含め、中長期的な成長期待</li> </ul>	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体電子等における各種設備投資継続により安定基盤ビジネスとして堅調に推移</li> <li>先端デバイス等の研究開発活発化に伴い表面分析装置堅調</li> </ul>	

Copyright © 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

9

カレンダーイヤー25年～26年にかけての投資動向です。

まず半導体についてですが、DRAMではHBM関連の投資が引き続き継続しており、特に韓国のトップメーカーとのビジネスが第1四半期から貢献しています。

NANDに関しては、ストレージ需要や生成AI関連の需要による投資が継続しています。

ロジックでは、先端ノードの投資が堅調に推移しており、中国向けを中心とした成熟ノードのMHM工程の展開が加速しています。

また、北米における外資メーカーによる投資も開始される見込みです。

次に各種電子デバイスですが、生成AI向けのWLPビジネスが引き続き好調であり、ハイブリッドボンディング向けのアッシング装置投資も期待されています。

PLPの開発投資も今期に見込んでいます。また、ARやVR向けの中国のオプトデバイスへの投資も見込まれています。

パワーデバイスについては、中国の大手デバイスメーカーを中心に8インチSiC投資の引き合いが増加していますが、一部顧客からの遅延要請等もあり、受注タイミングに遅延傾向が見られます。

ディスプレイ分野では、IT OLED向けの投資が継続しており、設備の追加・改造案件による持続的な貢献が見込まれます。

バッテリーに関しては中長期的な成長が期待されるものの、市場形成は依然として不透明な状況です。

最後にコンポーネントなどについてですが、半導体電子分野での各種設備投資が活発化していることから、安定した基盤ビジネスとして堅調に推移しています。

また、先端デバイスの研究開発が活発になる中で、表面分析装置も堅調に推移する見込みです。

## 2026年6月期 業績予想

- » 受注高：半導体投資回復、先端パッケージングビジネス活発化、OLED追加投資継続等で年間計画に変更なし
- » 売上高・各利益（率）：下期にかけて着実な改善を見込み、業績予想・配当予想に修正なし

【単位：億円】	25/6期	26/6期			前期比	
		上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
受注高	2,256	1,200	1,300	2,500	+244	+11%
売上高	2,512	1,155	1,345	2,500	-12	-0%
売上総利益	799	355	470	825	+26	+3%
率	31.8%	30.7%	34.9%	33.0%	+1.2pt	-
営業利益	265	90	195	285	+20	+7%
率	10.6%	7.8%	14.5%	11.4%	+0.8pt	-
経常利益	286	90	195	285	-1	-0%
率	11.4%	7.8%	14.5%	11.4%	-0.0pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	65	135	200	+33	+20%
率	6.6%	5.6%	10.0%	8.0%	+1.4pt	-
1株あたり配当金（円）	164			164	-	

Copyright © 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

10

当期の業績予想です。

受注高については、半導体投資回復、先端パッケージングビジネス活発化、OLED追加投資継続等で年間計画に変更ございません。

売上高・各利益項目についても、下期にかけて着実な改善を見込んでいるため、業績予想・配当予想に修正はございません。

**次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画**

JOINT3は、株式会社レゾナック社が設立した共創型評価プラットフォームで、材料・装置・設計企業が連携し、パネルレベル有機インターポーザー向けの材料・装置・設計ツール開発を加速します。

当社は、プラズマアッシングやパネルレベルスパッタリング装置の実績を活かし、シードスパッタリング装置を導入して技術深化と装置改良を進め、パッケージ技術の課題解決と製品価値向上を目指します。

生成AIや自動運転の拡大に伴い、インターポーザーの大型化によりシリコンから有機材料への移行や円形ウェハから四角パネル形状への転換が進んでいます。

**Imec Programへの参加と今後の協業**

当社は、ベルギーに拠点を置く先端半導体開発機関Imecのプログラムへの参加を決定しました。Imecは世界有数の研究開発機関として、最先端の半導体プロセス技術や材料開発において豊富な知見と高度な開発インフラを有しています。

当社は同機関との連携を通じて、これらの知見や開発環境を活用し、次世代およびその先の半導体デバイス開発を一層加速させることを目指します。

今回の参画により、グローバルな技術連携を強化し、持続的な技術革新に取り組んでまいります。



Copyright © 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

11

トピックスです。

次世代半導体パッケージング技術の向上に向けて  
レゾナック社が設立したコンソーシアム「JOINT3」に参画しています。

また先端半導体の開発を加速させるため  
Imecのプログラムに参加しています。

これらの取り組みを一層加速させ、今後も成長に向けて邁進してまいります。

## 品目別内訳割合・営業利益率順位 (26/6期 1Q)

### ■ 品目別内訳割合

受注高

売上高

品目	受注高	売上高
<b>半導体電子</b>	<b>180億円</b>	<b>162億円</b>
・メモリ	2割弱	3割弱
・ロジック	3割強	2割弱
・電子部品	1割半ば	2割強
・パワー半導体	数%	1割強
・実装	3割強	2割弱
<b>ディスプレイ・エネルギー</b>	<b>130億円</b>	<b>111億円</b>
・LCD	4割強	3割強
・OLED	5割弱	6割半ば
・バッテリー	-	数%
・その他	1割強	数%

### ■ 営業利益率順位

順位	品目
1	コンポーネント
2	一般産業
3	ディスプレイ・エネルギー
4	その他
5	材料
6	半導体電子

※全社平均営業利益率は 4)その他 と 5)材料 との間

**ULVAC**